

# 2024中国新一代信息产业制造展览会(深圳电子展)

产品名称	2024中国新一代信息产业制造展览会(深圳电子展)
公司名称	FCE展览
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国
联系电话	15989233176

## 产品详情

2024第十二届中国电子信息博览会

The 12th China Information Technology Expo 2024

时间：2024年4月9-11日

地点：深圳会展中心(福田)

参展联络：徐妍（手机号看联系栏）

指导单位

工业和信息化部

深圳市人民政府

主办单位

赛艾特会展(深圳)有限公司

中国电子器材有限公司

中电会展与信息传播有限公司

深圳市博远国际展览有限公司

组织单位

## 展会概述

伴随我国新一代信息技术产业的快速发展，中国电子信息博览会(中文简称：电博会，英文简称：CITE)2024第十二届中国电子信息博览会定于2024年4月9-11日在深圳会展中心(福田)举办，自2013年举办以来已走过了十一年征程。作为亚洲规模最大的综合性电子信息博览会，电博会组委会以“全球视野，国际一流，创新引领，服务产业”为理念，为产业链上下游协同创新提供了高效交流平台，促进电子信息产业与国民经济各领域进一步融合赋能，推动中国数字经济实现高质量发展。

聚合创新资源，推进科技创新，促创新成果转化，增科技辐射力

近年来，随着集成电路、云计算、大数据、人工智能、5G、新型显示等数字技术的发展，人类社会正逐步进入数字经济时代，超高清视频、虚拟现实、先进计算等领域发展步伐进一步加快，信息技术与实体经济的融合日益深入，持续赋能经济社会智能化转型。

其中，电子信息产业作为数字经济的基础，已经成为推动经济社会高质量发展的重要支撑与关键引擎。2021年，规模以上电子信息制造业营业收入突破14万亿元，同比增长14.7%，占工业营业收入比重达11.0%，已连续九年保持工业大行业地位。今年上半年，规模以上电子信息制造业增加值同比增长10.2%，高于规上工业增加值增速6.8个百分点，为保持经济运行在合理区间提供了有力支撑。

珠三角地区作为我国大的电子信息产品生产制造基地、全球重要的电子信息产业集聚区，并朝着电子信息产业集群发展不断迈进。2021年，广东规模以上电子信息制造业营业收入4.56万亿元，占全国32.3%，已连续31年位居全国第1；广东电子信息制造业企业有10家营收超1000亿元，19家企业进入2021年中国制造业500强，24家企业进入2021年全国电子信息百强，33家企业进入2021年全国电子元器件百强，数量均居全国第1。

2022年，广东省坚定推动高质量发展，加快建设现代产业体系，促进产业迈向全球价值链中高端，稳中求进培育发展以新一代电子信息产业集群为代表的20个战略性支柱产业集群和战略性新兴产业集群，大力发展半导体及集成电路、消费电子、超高清视频、硅能源等产业，出台一系列政策措施大力支持关键核心技术攻关，进一步优化和稳定产业链供应链，加快推动数字产业化和产业数字化，引进重大项目，布局重大平台，打造特色产业园区，营造良好的产业发展环境，促进电子信息产业成为推动实体经济提质增效、促进工业经济平稳增长、助力粤港澳大湾区建设的重要支撑力量。

持续推动创新链和产业链深度融合

中国电子信息博览会始终立足电子信息产业热土——深圳，放眼全国，辐射全球，设置了CITE主题馆、新型显示及应用馆、智电生活馆、电子数字生活馆、大数据云计算馆、新一代信息通信产业集群馆、创新智能科技互联应用馆、基础电子馆；聚焦智慧家庭、智慧终端、集成电路、5G应用、消费电子、新型显示、智能机器人、智能制造、电子元器件、信创、“专、精、特、新”等热点领域，随着数字经济、低碳绿色、国产替代成为经济发展的主流趋势，电博会不断推动内容创新与升级，助力数字生活、大数据、半导体、新能源、车联网、虚拟现实、元宇宙等领域不断加速融合创新，助力中国电子信息产业实现高质量发展。

同期高端热点活动金鑫，1+1+7+N洞见产业未来

为了提升中国电子信息博览会的性，CITE 2024创新优化推出“1+1+7+N”活动方阵；即举办“1”场中国电子信息博览会开幕峰会，举办“1”场新一代信息技术产业创新产品评选活动；“7”大重点领域方向活动“产业数字化”、“集成电路及半导体”、“超高清显示”、“智慧出行”、“信息技术应用

创新”、“5G+应用”、“消费电子及数字生活”；同期还有“N”场平行论坛活动；来自电子信息领域的专家学者、企业高层齐聚一堂，共同探讨了电子信息产业的发展新趋势与新机遇。

## 中国电子信息行业创新奖及金奖

为评选表彰代表我国电子信息行业具有突破性、先进性、方向性的产品和应用，中国电子信息行业创新评选组委会将联合电子信息领域10大行业协会，共同组织评选“中国电子信息行业创新金奖”及“中国电子信息行业创新奖”，旨在打造代表我国电子信息行业高创新水平的奖项。

## 围绕新兴领域及技术，N场平行板块方向设坛活动

围绕电子信息产业重点领域与技术，把握“产业数字化”、“集成电路及半导体”、“超高清显示”、“智慧出行”、“信息技术应用创新”、“5G+应用”、“消费电子及数字生活”七大板块垂直领域论坛矩阵，及精心策划打造五十余场论坛活动，聚焦汽车电子、物联网、电力电子、医疗、教育、民生消费等热门应用市场与高速发展行业。

## 展品范围

CITE品牌创新：智慧家庭、智能终端、信息安全、集成电路、大数据与存储、创新科技互联等。

新型显示及应用：元宇宙及虚拟现实技术、超高清视频、Micro-LED/Mini-LED、3D盖板玻璃、半导体显示、显示上下游材料设备及显示终端应用、电子纸供应链、智能穿戴和蓝牙音频供应链、TWS耳机新品、蓝牙耳机新品、智能声学新品等。

半导体产业及应用：半导体设备、半导体材料、半导体制造、半导体封装及测试、传感器及相关应用

电子生活生态：消费端电子、电子生活体验区、娱乐影像、跨境生态链等。

新一代信息产业制造：服务型机器人、工业机器人、3C产业制造、智慧工厂及自动化等。

物联智通应用技术：物联网应用、智慧城市、智慧交通等。

基础电子：电子元器件、仪器仪表及材料、特种电子、电子生产制造设备、IP及IC设计及解决方案等。

智能充电：电源芯片、第三代半导体、被动器件、新能源产品、消费类电源、智能化设备等。

智电生活：智电生活购物节、电竞环游GTS等。

大数据云计算：大数据与存储、Web3.0、数字藏品、元宇宙基础设施等。

智能驾驶与汽车电子技术、国际氢能产业链：智能新能源汽车、自动驾驶技术、智能辅助驾驶、车联网技术、国际氢能产业链等。

欢迎业界同仁踊跃报名参展CITE

2024，现正接受申请，请速与我们联系，索取参展合同及展位平面图！

知识科普：

随着集成电路技术的发展，对集成电路的封装要求更加严格。这是因为封装技术关系到产品的功能性，当IC的频率超过100MHz时，传统封装方式可能会产生所谓的“CrossTalk”现象，而且当IC的管脚数大于208 Pin时，传统的封装方式有其困难度。因此，除使用QFP封装方式外，现今大多数的高脚数芯片（如图形芯片与芯片组等）皆转而使用BGA(Ball Grid Array Package)封装技术。BGA一出现便成为CPU、主板上南/北桥芯片等高密度、高性能、多引脚封装的好选择。